

ニッケルレス最終表面処理プロセス
銅上の無電解パラジウム／金めっきプロセス
Final Surface Treatment Process without Nickel Plating
Electroless Pd/Au Plating Process on Cu

トップパラスNプロセス

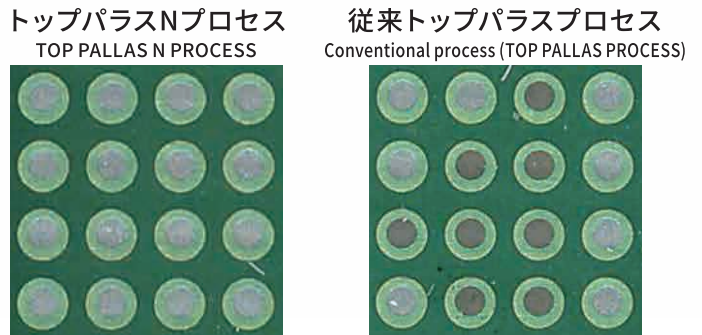
TOP PALLAS N PROCESS

- ニッケルレスのため高周波特性に優れる
Ni-less type process to use under high frequency
- はんだ接合性、金ワイヤボンディング性に優れる
Excellent in solder joint, gold wire bonding performance
- 耐折性、耐食性が良好
High folding endurance, great corrosion resistance
- ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability

触媒付与時の銅腐食を低減 Prevent copper corrosion in catalyzing step



パラジウム析出性が良好 High deposition ability of palladium plating



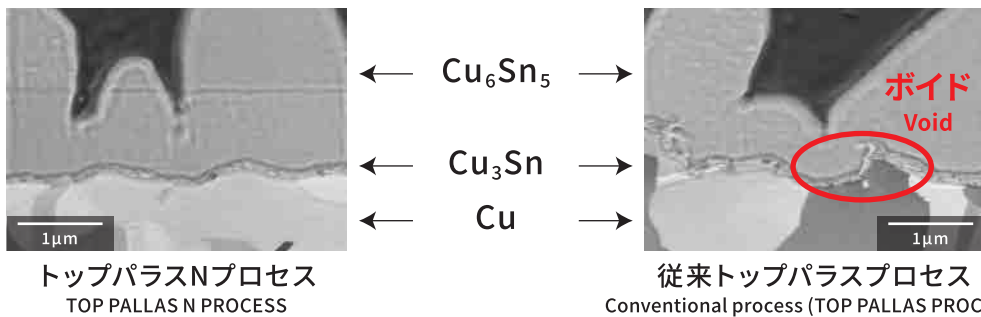
未析出なし
Deposition occurs.

未析出あり
No deposition

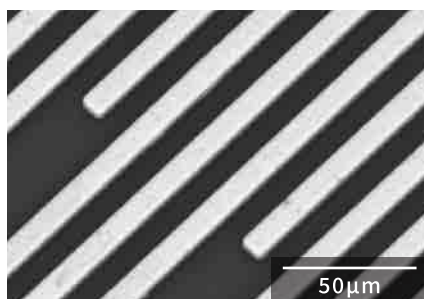
パラジウムめっき液に銅が混入(10ppm)した際のめっき析出性
Deposition performance when 100 ppm of copper is dragged into palladium plating bath

※基板パッド径:500μm
Pad diameter of substrate

優れたはんだ接合性 Excellent in solder joint performance



ファインパターン性に優れる Excellent in fine pattern ability



耐食性が良好 Excellent in corrosion resistance

	トップパラスNプロセス TOP PALLAS N PROCESS	従来無電解ニッケル/ 金めっきプロセス Conventional electroless Ni/Au plating process
外観 Appearance	 ほぼ腐食なし No corrosion	 全面腐食 Corrosion
ニッケル Nickel	—	4.0μm
パラジウム Palladium	0.10μm	—
金 Gold	0.05μm	0.05μm

SO₂ガス濃度: 5±3ppm
Concentration of SO₂ gas

温度: 40±2°C
Temperature

時間: 240時間
Treatment time: 240h